

“高散热润滑垫板产品开发及产业化(RH)” 成果登记公示信息

成果名称:	高散热润滑垫板产品开发及产业化(RH)
完成单位:	深圳市柳鑫实业股份有限公司,湖南柳鑫电子新材料有限公司,昆山市柳鑫电子有限公司
完成人员:	张伦强,黄宏锡,周永飞,唐明明,胡海波,贺瑜,杨勇成,黄建军
研究起止日期:	2021-01-01 至 2022-12-31
主要应用行业:	制造业
高新技术领域:	新材料
评价单位:	广东省科源科技成果评价有限公司
评价日期:	2024-12-16
成果简介:	<p>①课题来源与背景: 企业自主研发。</p> <p>②技术原理及性能指标: 总厚度: $2.5 \pm 0.15\text{mm}$; 铅笔硬度: $\geq \text{H}$; 邵氏硬度: 75 ± 5; 翘曲度: $\leq 0.5\%$; 高散热功能树脂相变温度: $< 70^\circ\text{C}$; 相变热焓: $> 150\text{J/g}$。</p> <p>③技术的创造性与先进性: 经科学技术部西南信息中心查新中心查新:在所检文献以及 时限范围内,除本项目委托单位发表的专利及文献报道外,国内 外未见相同文献报道。本项目具有新颖性。</p> <p>④技术的成熟程度,适用范围和安全性: 基于以上技术成果,开发的产品经第三方检测机构--华测检 测认证集团股份有限公司检测符合印制电路板相关标准,已形成 批量销售,客户反映良好。</p>

⑤应用情况及存在的问题：

润滑垫板优异润滑散热优化钻孔孔壁品质，能进一步提升 PCB 产品的可靠性。目前 PCB 客户如沪士电子、东莞美维、兴森科技、广州添利、珠海德丽、惠州美锐等均已批量导入，主要应用于高多层高速厚板、厚铜板等钻孔品质的提升，深南电路、广合科技等也正在逐步导入中！2024 年预计可实现销售额 2000 万元。

⑥历年获奖情况：

2019 年 12 月，荣获“国家科学技术进步奖”二等奖

2020 年 12 月，荣获工信部“制造业单项冠军企业（产品）”

2021 年复审获通过“深圳知名品牌”

2023 年 3 月，获“国家专利密集型产品备案认定试点企业”

2024 年 4 月，复审通过获工信部“制造业单项冠军企业”